

氰酸酯 层压板和半固化片

优点

- 高散热效能
- 低Z轴膨胀
- 优异的电气特性
- 支援高讯号速度

产品应用

- 背板
- BGA多层
- MCM-L
- 汽车
- 雷达和航空



N8000是一种高Tg氰酸酯层压板和预浸材料，可提供卓越的性能和产品完整性，是具有较高层数、更细的线条和空间以及更大面板尺寸的电路板设计的理想选择。

高散热效能

- 通过DSC的250°C Tg
- 低Z轴膨胀
- 适合高层数、精密PCB设计
- 高速度、高可靠性和可控阻抗板应用的优异性能

优异的电气特性

- 支援标准环氧树脂或聚酰亚胺无法提供的讯号速度功能
- 低Dk和Df以满足高速、低损耗设计要求

典型氰酸酯加工

- 在182°C下按压240分钟，200-300psi

符合UL 94V-0 与 IPC-4101/71规格

UL档案编号: E36295

属性	条件	典型值	单位	试验方法
电气性能				
介电常数	@ 2.5 GHz	3.6		IPC-TM-650. 2. 5. 5. 5
	@ 10 GHz	3.5		
损耗因子	@ 2.5 GHz	0.011		IPC-TM-650. 2. 5. 5. 5
	@ 10 GHz	0.011		
体积电阻率	C - 96 / 35 / 90	10 ⁷	MΩ - cm	IPC-TM-650. 2. 5. 17. 1
	E - 24 / 125	10 ⁷		
表面电阻率	C - 96 / 35 / 90	10 ⁷	MΩ	IPC-TM-650. 2. 5. 17. 1
	E - 24 / 125	10 ⁷		
介电强度		6. 5x10 ⁴ (1650)	V/mm (V/mil)	IPC-TM-650. 2. 5. 6. 2
热性能				
*玻璃化转变温度 (T _g)	DMA (° C) (Tan d Peak)	300	° C	IPC-TM-650. 2. 4. 25c
裂解温度 (TGA)	裂解温度 (TGA) (5% wt. loss)	376	° C	IPC-TM-650. 2. 4. 24. 6
T-260	分层时间 @ 260° C	60+	minutes	IPC-TM-650. 2. 4. 24. 1
机械性能				
剥离强度	1 oz (35μ) Cu 漂锡后测试	1.40 (8.0)	N/mm (lbf/inch)	IPC-TM-650. 2. 4. 8
X/Y CTE	-40° C to + 125° C	11 / 13	ppm/° C	IPC-TM-650. 2. 4. 41
Z 轴膨胀 (43% RC)	50° C to 260° C	2.5	%	IPC-TM-650. 2. 4. 24
杨氏模量 (X/Y)		20.4 / 20.4 (3.0 / 3.0)	GN/m ² (psi x 10 ⁶)	ASTM D3039
泊松比率 (X/Y)		0.14 / 0.14		
化学/物理特性				
吸水率		< 0.05	wt. %	IPC-TM-650. 2. 6. 2. 1

* DMA 是测量 T_g 的首选方法 - 其他方法测量值仅供参考。

- 提供的所有试验数据均为典型值，并非规范值。如需查看关键规格公差，请直接联系公司代表。
- N8000的层压厚度为2mil (0.05毫米) 以上。
- N8000提供最常见的尺寸。
- 请联系 AGC 了解能否提供任何其他结构、铜重量和玻璃样式，包括超低粗糙度铜箔和 RTFOIL®

